广钢气体 20260831

广钢气体：电子大宗气体中标率首超外资，全球化与先进制程双向突破

摘要

- 2026H1 营收 10.56 亿，同比增 30.18%，EPS 0.19 元增 111%，电子大宗气体占比升至 79.2%。
- 2024 年国内集成电路及半导体显示新建项目中标产能占比 41%，首次超越三大外资巨头位列行业第一。
- 2026 年 8 月新签订单 16-17 万方/小时，投资额超 15 亿，其中半导体项目占比接近 90%。
- 下半年国内半导体电子大宗气体市场空间约 100 万方/小时，公司目标获取 50%市场份额。
- 与韩国 AirFirst 签署战略协议，Super-N 系列产品借此进入韩国三星、海力士等先进制程供应链。
- 超临界 CO2 输送系统已在京、肥落地，作为国内唯一供应商，其毛利率高于电子大宗业务整体水平。
- 氦气业务通过全球多渠道气源布局及临时调价措施，在供应紧张环境下保障了利润贡献与毛利稳定。

Q&A

请介绍一下公司 2026 年上半年的整体业绩表现、核心驱动因素以及各业务板块的收入情况？

2026 年上半年，公司实现营业收入 13.33 亿元，同比增长 19.62%；归母净利润为 2.56 亿元，同比增长 117.73%；扣非归母净利润为 2.29 亿元，同比增长 121.63%。利润增速远超收入增速，盈利弹性得到充分释放。基本每股收益为 0.19 元，同比增长 111%；加权平均净资产收益率为 4.17%，较上年同期提升 2.17 个百分点。经营活动产生的现金流量净额为 3.61 亿元，资产负债率为 33.6%，财务结构稳健。 业绩增长的核心驱动力主要来自两个方面：一是电子大宗气体新建项目的

持续投产与放量，这是业绩增长的核心引擎；二是公司在全球氦气供应链上的资源统筹与保障能力，在特殊市场环境下对当期利润形成了一定贡献。 从业务板块来看，电子大宗气体作为核心业务，上半年实现收入 10.56 亿元，同比增长 30.18%，占营业收入比重从 2025 年上半年的 76%提升至 79.2%。其中，电子大宗现场制气业务实现收入 8.95 亿元，占主营业务收入的比重为 70%。通用工业气体作为重要补充，上半年实现收入 2.17 亿元。

公司在氦气业务方面的战略布局和竞争优势体现在哪些方面？

公司在氦气业务上已构建起长期的竞争壁垒。面对 2026 年以来因地缘政治等因素导致的全球氦气供应链阶段性紧张，公司始终将保障战略客户的稳定供应置于首位。具体优势体现在以下几个方面： 一、在气源布局上，公司是国内唯一实现大批量长期稳定协议及多区域气源集中采购的内资气体企业，已构建了涵盖中东、欧洲、北美的多渠道货源体系。 二、在储运能力上，公司累计投资近百台液氦冷箱，形成了全球化的氦气资源统筹调配能力。 三、在战略储备上，公司与中国科学院紧密合作，推进国内首个小分子深地储气项目建设，旨在打造“氦气银行”，以夯实国内氦气战略储备。 四、在保供能力上，已在上海、武汉、广州等地建成智能化氦气充装工厂，持续提升储备能力与供应周期。

公司在业务拓展、市场地位及国际化布局方面取得了哪些新进展？

2026 年上半年，公司业务开拓成果显著。在半导体集成电路领域，公司在西南地区落子成都，成功获取了第 11 个 12 英寸芯片配套供气项目，并为战略客户在合肥的扩产项目提供配套服务。截至 2026 年上半年，公司已累计获得 11 座 12 英寸晶圆厂客户的认可。 在半导体显示领域，公司深度服务华星光电、惠科等行业龙头，并成为全球首条规模化 TCL 华星第 8.6 代印刷 OLED 半导体显示产线的电子大宗气体供应商。目前，公司已为 8 条高世代显示产线供应电子大宗气体。市场地位方面，2024 年，公司在国内集成电路制造和半导体显示领域的新建现场制气项目中，中标产能占比达到 41%，首次超越三大外资气体公司，位列行业第一。 国际化布局方面，公司的智能装备制造基地已获得美国 ASME 认证和韩国 KGS 认证。2026 年 8 月，公司与韩国气体运营公司 Air First 签署长期战略合作协议，将联合开发韩国半导体专用超高纯制氮解决方案，标志着公司 Super-N 系列产品即将进入国际市场。

公司在技术创新和研发方面的投入与成果如何？

公司持续加大研发投入，致力于从国产替代向自主可控迈进。2026 年上半年，公司研发费用为 5,799 万元，同比增长 19.05%。研发人员数量增至 164 人，占公司总人数的 14.21%。在核心装备方面，公司自主研发的 Super 系列超高纯制氮装置已在中国半导体制造领域实现成熟的商业化应用。2025 年 8 月，首套完全自研自制的 Super 30K Pro 超高纯制氮机成功下线，能够稳定产出纯度达到 ppb 级（9N 级）的超高纯氮气。在此基础上，公司正持续推进技术的迭代与产品

升级。

公司 2026 年半年度的利润分配方案是怎样的？

经董事会审议，公司计划实施 2026 年半年度利润分配方案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税），合计拟派发现金分红约 1.03 亿元，占 2026 年半年度归母净利润的 40.21%，以积极回报股东。

2026 年第二季度毛利率同比提升的主要驱动因素是什么？电子大宗气体项目的产能爬坡和氦气业务分别贡献了多少？

公司 2026 年第二季度毛利率同比确实有所提升，这主要源于两个方面。一方面，部分项目的产能爬坡带来了毛利率的自然增长。另一方面，由于今年氦气市场特殊的供应状况，为保障半导体及面板客户的稳定供应，公司在前端保供时供应链成本有所上升，因此采取了临时性的价格调整措施，这使得氦气业务对毛利率的提升也做出了贡献。

公司 2026 年上半年的经营性净现金流相较去年同期有所下滑，具体原因是什么？对第三季度及全年的现金流表现有何展望？

2026 年上半年经营性现金流同比下滑，主要是由于在系统切换过程中，与几家大客户的内部结算流程受到影响，导致 6 月份的回款情况不理想，这是一个时点性问题。实际上，相关款项已在 7 月中上旬大额回笼，现金流状况在 7 月份已得到显著改善。因此，预计下半年的经营性净现金流表现将优于上半年。从全年来看，随着业务增长，预计 2026 年全年的经营性净现金流将实现同比增长。

当前电子大宗气体下游的景气度如何？公司 2026 年上半年的新签订单、市场份额以及下半年的项目展望是怎样的？

2026 年是半导体行业的发展大年，也带动了电子大宗气体行业的投资、招标和新项目落地。截至 2026 年 8 月底，公司已获取的新项目规模超过 15 万方/小时，具体约在 16 至 17 万方/小时，对应总投资额超过 15 亿元，其中半导体类项目占比接近 90%。展望未来四个月，市场机会依然广阔，尤其是在武汉、合肥、北京、上海等半导体产业聚集地。经估算，2026 年全年国内半导体及泛半导体领域的电子大宗气体项目总用气量规模预计将达到 100 万方/小时，这些项目大多会在今年底前后确定气体供应商。在下半年可预见的项目中，公司已在部分项目中取得明确优势，预计可锁定超过 10 万方/小时的规模，涉及投资额达数亿元。结合上半年已获取的订单以及下半年持续跟进的重要项目，公司力争在 2026 年占据市场份额的半壁江山。

关于截至 8 月底新签的 16-17 万方/小时订单，其中存量客户扩产和新客户项目的比例如何？下半年展望的 100 万方/小时市场机会，主要是新增项目还是现有客户扩产？

截至 8 月底所获得的 16-17 万方/小时订单规模，绝大部分来自于新建项目，而非简单的扩产扩建。其中，核心项目多为首次合作的新客户，例如在成都和上海新落地的项目。对于下半年约 100 万方/小时的市场机会，其中既包括现有客户未来持续扩张带来的机会，其总量规模可达数十万方/小时，也包括公司重点关注的尚未进入的核心客户所带来的新项目机会。公司在开拓新客户方面已取得一定进展，下半年将持续发力，以期在 2026 年取得更好的业绩。

您所追踪的约 100 万方/小时的市场机会是否仅限于国内市场？

是的，前述统计的 100 万方/小时市场机会均来自国内半导体客户未来的发展规划，不包含任何海外市场的扩张预期。

公司在海外市场的拓展战略是怎样的，特别是与韩国 AirFirst 的合作背景及未来方向？

AirFirst 公司的前身与广钢气体背景相似，曾是林德持股 50%的合资公司。在全球反垄断审查期间，林德与普莱克斯合并时，其股权被韩国及国际财团收购，成为一家韩资企业。因此，两家公司同属原林德体系，各自在韩国和中国半导体市场进行开拓。AirFirst 在韩国市场拥有深厚基础和先天优势，其强项在于现有项目的运营管理，是全球电子大宗气体生产领域的头部企业之一。鉴于韩国、美国和中国是全球半导体扩产最积极的三大市场，公司认为与 AirFirst 的战略合作是进入韩国市场的一个较快途径。

广钢气体与 Air First 达成长期战略合作的背景、具体合作范围以及战略意义是什么？

广钢气体在国内半导体市场的发展过程中，从显示面板领域逐步迭代至半导体行业，并在此期间培养了技术创新能力，特别是核心装备的自研自制能力，例如半导体 Super N、Fast N 等装置。这构成了公司进入半导体行业的核心竞争力。与 Air First 的合作，其背景在于双方均源于林德体系。Air First 在剥离林德股权后，面临着需要核心装置以支持未来增长的需求，但由于与林德在韩国市场已形成竞争关系，难以再获得林德在装备方案与技术上的支持。广钢气体的电子大宗气体装置恰好能满足 Air First 的需求。双方的接洽始于较早之前，经过了长时间的沟通以及客户多轮认证，最终认可了广钢气体在装置设备方面的能力。双方近期签订的是一份长期战略框架合作协议。该协议不仅涵盖了 Air First 目前已有的项目订单，还约定了未来在韩国主要市场的扩张项目。此外，如果韩国的重点半导体客户在海外市场扩张，且 Air First 跟随提供服务，这些项目也包含在合作协议之内。 此次合作的核心是电子大宗现场制气项目，更具体地说是半

导体电子大宗气体设备的供应。对广钢气体而言，这不仅是业务拓展，更是一次战略合作。通过进入 Air First 的供应体系，公司旨在学习和感受韩国半导体客户作为行业最先进和最严苛代表，其对电子大宗行业的要求。同时，这也为公司提供了接触更先进制程、学习更规范的行业先进技术的机会，为中国半导体产业的未来发展做好技术储备。

公司在超临界二氧化碳产品方面的应用场景、市场空间、竞争格局以及商业模式和利润率水平是怎样的？

超临界二氧化碳目前主流应用于制程较为先进的存储芯片工厂，特别是在高宽深比结构中的清洗工艺环节。它作为传统湿电子化学品的替代方案，能够更有效地清洗沟槽，从而提升产品良率并帮助客户降低成本，同时二氧化碳的污染排放较少。目前，公司已有两个商业化项目分别落地合肥和北京，并计划很快在武汉将该系统商业化。 从市场空间来看，随着存储芯片的扩产和先进制程的演进，对超临界二氧化碳输送系统的需求正日益增长，未来可能成为每个芯片厂的标准配置。目前在中国，该技术的应用尚处早期阶段，仅有少数头部的先进制程工厂在使用，除广钢气体外，其余均采用外资解决方案，因此公司是国内首家、全球唯二的供应商。参考韩国市场，该系统应用已较为普遍，市场规模达到数十套级别，预示着中国市场未来有较大的发展空间。目前公司正在跟进的客户，基本都有引入超临界二氧化碳系统的计划。 商业模式上，与大宗气体业务类似，公司通过投资建设设备系统，然后销售相关材料。在利润率方面，由于该产品刚进入国产替代阶段，初期利润率水平较为可观。一方面，新系统相较于外资方案具备一定优势；另一方面，公司位于芜湖的工厂已改造为能够大规模生产电子级二氧化碳的基地，自供电子级二氧化碳产品能显著提升整个系统的利润率水平。总体而言，该业务的毛利水平高于公司电子大宗业务的整体水平。

公司在电子特气领域的在研产品、生产进展、目标客户以及预计的商业化时间表是怎样的？

公司目前主要在开发和生产三个电子特气品种。 第一，在湖北潜江，公司进行六氟丁二烯的合成与提纯。合成方面，近期已产出粗品，正在进行工艺调试；提纯方面，工艺设计与设备安装已基本完成。预计在 2026 年年底前，可以调试出高纯级别的产品，之后将进入客户验证和导入阶段。 第二，在合肥，公司进行溴化氢的提纯，主要应用于当地存储客户的刻蚀和清洗工艺。预计也将在 2026 年年底左右产出产品。 第三，在上海，公司设有一个电子级氯化氢的提纯工厂，主要供应给存储和大硅片行业的客户，例如伊斯伟等传统客户在该领域用量较大。目前正在进行产品验证和导入，预计同样在 2026 年年底左右有产品产出，随后进行后续的验证导入。 关于商业化，预计这几款产品在 2026 年主要进行客户验证，可能会产生少量收入，但形成规模化的销售收入预计要到 2027 年。

关于下半年电子大宗项目的市场规模以及公司的目标是什么？

下半年电子大宗项目的总体市场规模预计超过 100 万方，公司的目标是争取获得其中一半的市场份额。

在电子大宗气体市场，公司是否有明确的规模目标，例如达到十多万立方米的规模？

公司的目标是占据百万方级别市场的半壁江山。目前已具备十多万立方米的规模，预计下半年还将有十多万立方米的新增规模落地，届时总规模将达到二三十万立方米。公司正持续跟进多个项目，期望下半年能取得更好的成果，最终目标是达到百万方级别市场一半的份额。

关于氦气市场，2026 年以来整体的价格涨幅如何？同时，受地缘政治影响，与 2025 年相比，今年从美国、卡塔尔及俄罗斯进口氦气的情况有何变化？

关于具体的氦气价格，因与客户签有保密协议，不便透露具体数据。但从市场趋势看，2026 年上半年受国际事件影响，市场价格，尤其是零售市场价格，出现了大幅上升。公司为稳定供应链，与客户商议了合理的价格，涨幅不像零售市场那样极端，但对半年度财务报表也做出了一定贡献。 在气源进口方面，上半年经历了诸多挑战。3 月份中东的美伊战争扰乱了全球供应链，4 月份俄罗斯也对氦气出口实施了紧急限制。为应对这些影响，公司积极调整全球供应链，将部分采购从原先的中东地区转移至北美。在俄罗斯供应受限后，进一步加大了北美地区的进口量，并尽力从中东地区获取剩余货源以满足国内生产需求。 为保障半导体等重点客户的供应，公司在上半年进行了一定的客户切换，优先确保半导体客户的用气稳定，因为一旦断气将导致其生产工艺停滞，对产线造成巨大影响。从供应量来看，过去几年广钢气体的氦气业务量年增长率维持在 20%-30%，高时可达 40%。但受 2026 年上半年国际形势影响，业务量未实现增长，甚至有少量下滑。未来，国内氦气需求增长的主流驱动力将来自半导体行业的发展，预计 2026 年新建的半导体产能将带来大量的氦气需求。目前，卡塔尔、中东及俄罗斯的生产、物流和出口仍未完全恢复到冲突前的正常水平，国内市场的供应链风险依然存在，公司会提前做好各项安排，保障重点客户的供应服务。

如果更换氦气气源，是否需要客户重新进行认证？这个认证周期大约需要多长时间？

气源变更通常不会造成太大影响。全球主要的氦气气源地相对集中，例如卡塔尔内部不同产区（如卡塔尔一期、二期）之间的切换影响不大。同时，来自美国等地的气源已是全球供应体系的一部分，并且在三星、台积电等主流半导体厂商有过供应记录，拥有较好的供应体系和市场接受度。因此，这类气源变更的客户接受度会比较好。此外，在氦气供应紧张时期，例如 2026 年 3、4 月份全球短缺的

情况下，客户为了保障生产，其认证流程或接受程度会变得更为快捷和便利。

考虑到近期氦气市场价格相较于第二季度有所回落，公司如何展望下半年氦气业务的毛利率水平，是否存在下降压力？另外，氦气银行项目的最新进展及后续时间规划是怎样的？

市场上观察到的价格回落更多体现在零售端，例如瓶装气等终端市场。在三、四月份供应极度紧张时，零售市场价格的涨幅远高于长期供应市场，尽管其交易量不大。近期随着各方努力协调，整体供应逐步恢复正常，导致之前被抬高的零售价格出现回落。 广钢气体的氦气业务主要面向半导体核心客户，采用的是长期稳定供应协议模式，更注重供应链的持续稳定。价格体系与零售市场略有不同，主要通过与客户进行长期协商来确定，并在一个相对较长的时间内保持稳定，因此受零售市场短期价格波动的影响不大。 关于氦气银行项目，目前仍在持续推进中，包括核心设备、工程建设以及储气验证等工作都在进行。公司将根据国内氦气的供需关系，有序地开展存储工作。现阶段，氦气银行的主要功能是进行氦气的存放。 补充来看，当前氦气市场的供应格局并未得到根本性改善，例如中东地区许多工厂仍处于低负荷运转状态，这种局面会持续多久尚难判断。基于此，公司上半年为保障关键客户供应，放弃了许多零售客户，并与主要客户达成了一项临时的调价措施。该调价措施将维持到 2026 年年底。因此，结合下半年部分新的电子大宗项目投产，预计毛利率水平将保持稳定。

AirFirst 在与广钢气体合作前后，其在韩国市场的订单获取能力和市场份额有何变化？预计合作后其市场份额能提升到何种水平？

AirFirst 在合作前没有自身的核心解决方案，其设备主要使用林德的产品，并与液空有部分合作。在独立运营后，AirFirst 与林德、液空转为竞争关系，共同竞争三星、海力士及 LG 等客户的电子大宗气体业务。目前，AirFirst 在三星的业务占比较高，例如在三星平泽工厂的 P3、P4 项目中，其市场份额超过 50%。从整体市场来看，AirFirst 在韩国工业气体市场的总占有率约为 20%，但在电子大宗气体领域的份额远高于此平均水平。此外，AirFirst 作为韩国唯一的本土气体公司，在本土供应链优先的背景下，未来在三星和海力士的业务拓展机会众多，同时 LG 也是其长期合作伙伴。根据韩国政府公开信息，三星和海力士每年的资本支出超过 1 万亿人民币，其中电子大宗气站相关的 Capex 每年约有 100 亿人民币，对应几十亿的核心解决方案市场规模。通过与广钢气体的全球合作（包括其在美国的业务），预计 AirFirst 能从中获得可观的市场份额，这将对业绩产生积极影响。同时，这部分业务的毛利水平预计将达到国际化的合理标准，可能优于国内市场。



面对市场对广钢气体客户集中度和市场占有率的担忧，公司未来的发展战略是什么？如何看待当前的市场竞争格局和未来的增长支撑？

未来五年，仅中国主流 12 英寸晶圆厂市场每年的资本支出预计接近 5,000 亿人民币，对应每年超过 50 万方的电子大宗气体市场机会，以及 50 亿人民币的市场规模。这是一个持续扩大的市场，而非零和博弈。公司的龙头地位和市场份额不仅稳固，且在逐步扩大，计划在 2026 年年底实现对主流 12 英寸晶圆客户的全覆盖。当前，公司的产能、智能制造工厂的负荷以及技术团队等资源，尚不足以独立承担全部的国产替代任务。对于个别客户出于供应链安全考虑培养第二供应商的情况，公司表示理解。 电子气体行业的核心竞争力在于内功，需要经受市场和时间的长期考验。公司的独特性和核心竞争力体现在三个方面： 第一，独特的体制机制。作为脱胎于外资的国有企业，兼具国企的担当和外资的专业性，并拥有全球化的布局和视野。 第二，专业的创业团队。电子大宗气体行业需要持续创新，团队不断进行工艺和产品的迭代，以满足客户日益严苛的要求，例如杂质控制从几种增加到几十种，纯度要求达到 ppt 甚至更低级别，以及未来应对 1.5 万、3 万、5 万片甚至 10 万片产能的需求。 第三，深厚的历史沉淀。公司经历过不同周期和行业，深刻理解半导体行业的品控要求。 依托这些核心竞争力，公司计划在 2026 年下半年（即第三、四季度）的 100 多万方市场空间中，争取获得半壁江山，持续巩固并提升市场领先地位。